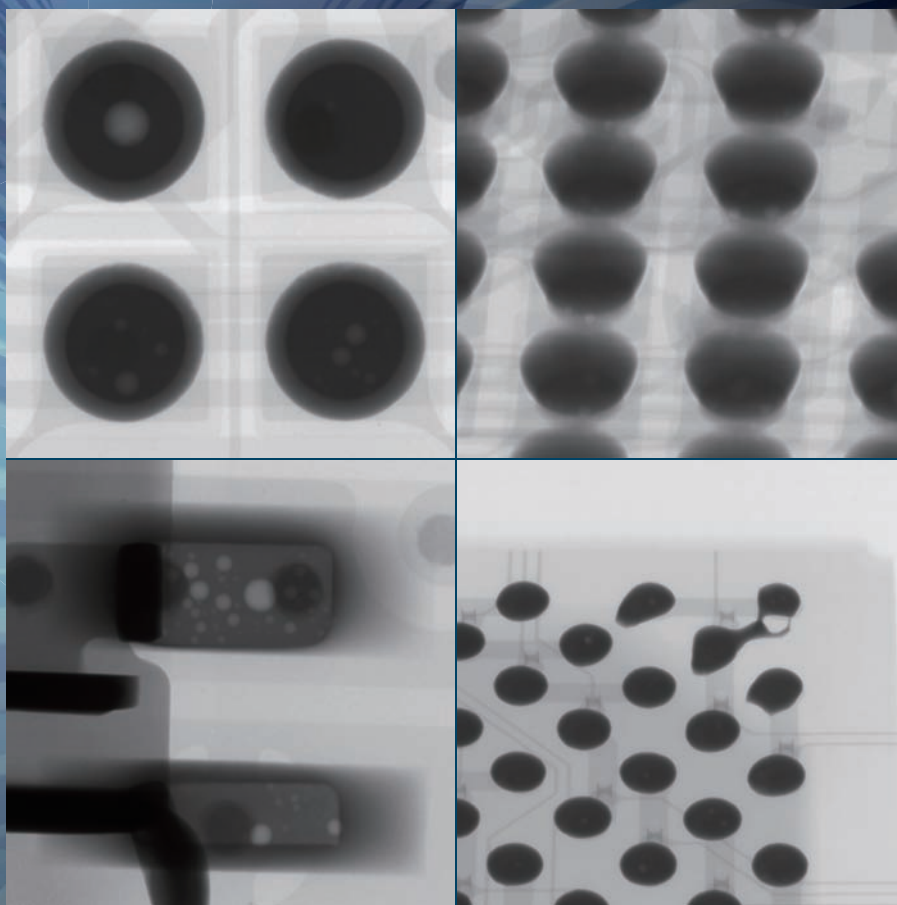


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

マイクロフォーカスX線検査装置

TOSMICRON-CH4090FD

現場での使いやすさを追求した実装基板検査用モデル

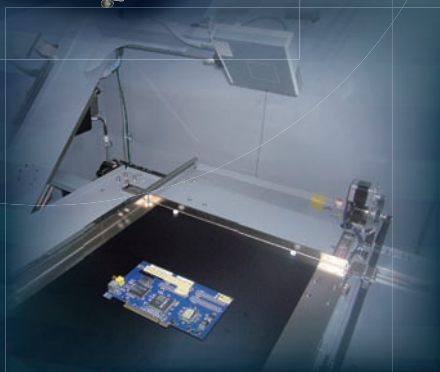


X線画像例

TOSMICRON-CH4090FDは、東芝のX線センシング技術を活用した実装基板の半田検査に最適なシステムです。BGAや部品半田状態などの鮮明なX線画像が得られます。また優れたユーザインターフェースにより簡単で効率的な検査が可能です。

特長

- メンテナンスフリーな密封管型マイクロフォーカスX線発生装置搭載
- 画像表現能力が高く、歪みのない鮮明な画像が得られるフラットパネル型センサ搭載
- 傾斜撮影により斜め方向から観察可能
- BGA ボイド計測ソフト搭載
- PC画面上ですべて操作できる快適なユーザインターフェース
- 設置場所を選ばないコンパクト設計

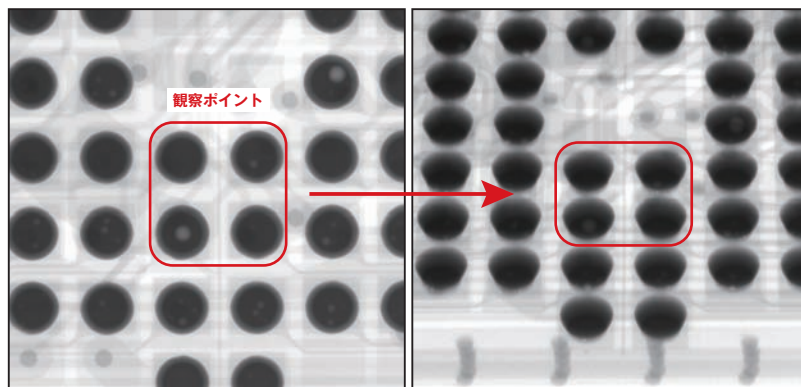


東芝ITコントロールシステム株式会社

TOSMICRON-CH4090FDの多彩な機能

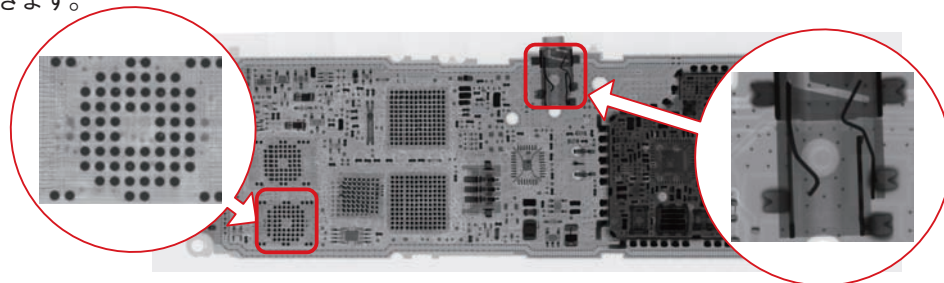
トラッキング機能(観察ポイント自動追跡機能)搭載

傾斜撮影しても、観察ポイントを逃さぬようにトラッキング(自動追跡)する機能が搭載されているため、様々な角度から安定したX線画像を得ることができます。



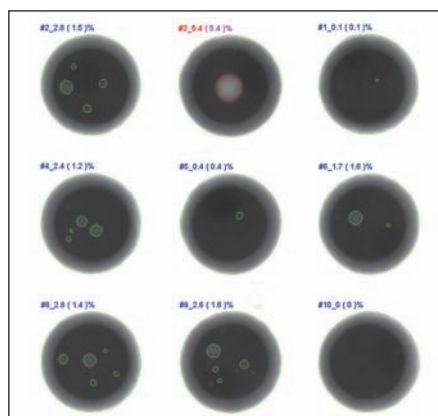
マップ機能

試料のX線マップ画像を撮ることにより、観察ポイントへ自在に移動することができます。また、観察したい部分の全体を画像表示することもできます。



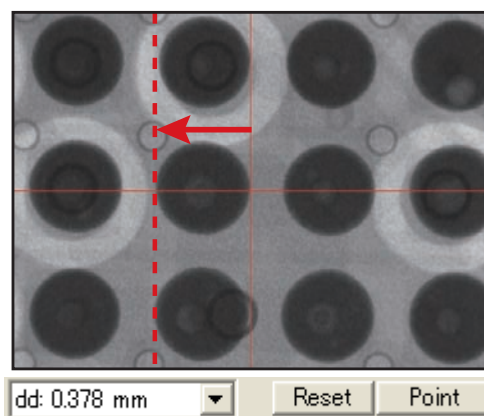
BGA ボイド測定機能

画面に表示されたBGA画像の測定が簡単にできます(ボイド率, 最大ボイド率, 真円度, 直径, 良否判定)。



リニア計測機能

試料テーブルの移動量で試料の寸法測定ができます。画像から測定するよりも早くて正確な測定ができます。



主仕様

X線発生装置	管電圧90 kV, 焦点寸法5 μ m
X線センサ	FPD(フラットパネルデテクタ)
倍率	約10~160倍
試料テーブルサイズ	400×350 mm
傾斜角度	0-60度
ソフトウェア機能等	画質改善, 画像解析・計測, メモリボックス, マップ, 画像撮影条件再生, リニア計測, 試料テーブル自動送りなど
外形寸法	約1050(W)×1050(D)×1430(H) mm
質量	約550kg
X線遮蔽能力	1 μ Sv / h以下(装置外表面)

東芝ITコントロールシステム株式会社

検査システム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-9-11(第9中央ビル6階)

TEL: 03-5652-6881 FAX: 03-5652-6872

URL: <http://www.toshiba-itc.com/cat/cat.html>

※記載事項は設計変更、その他の理由により、お断りなく変更させていただくことがあります。

CAT-TM043J 08-08